

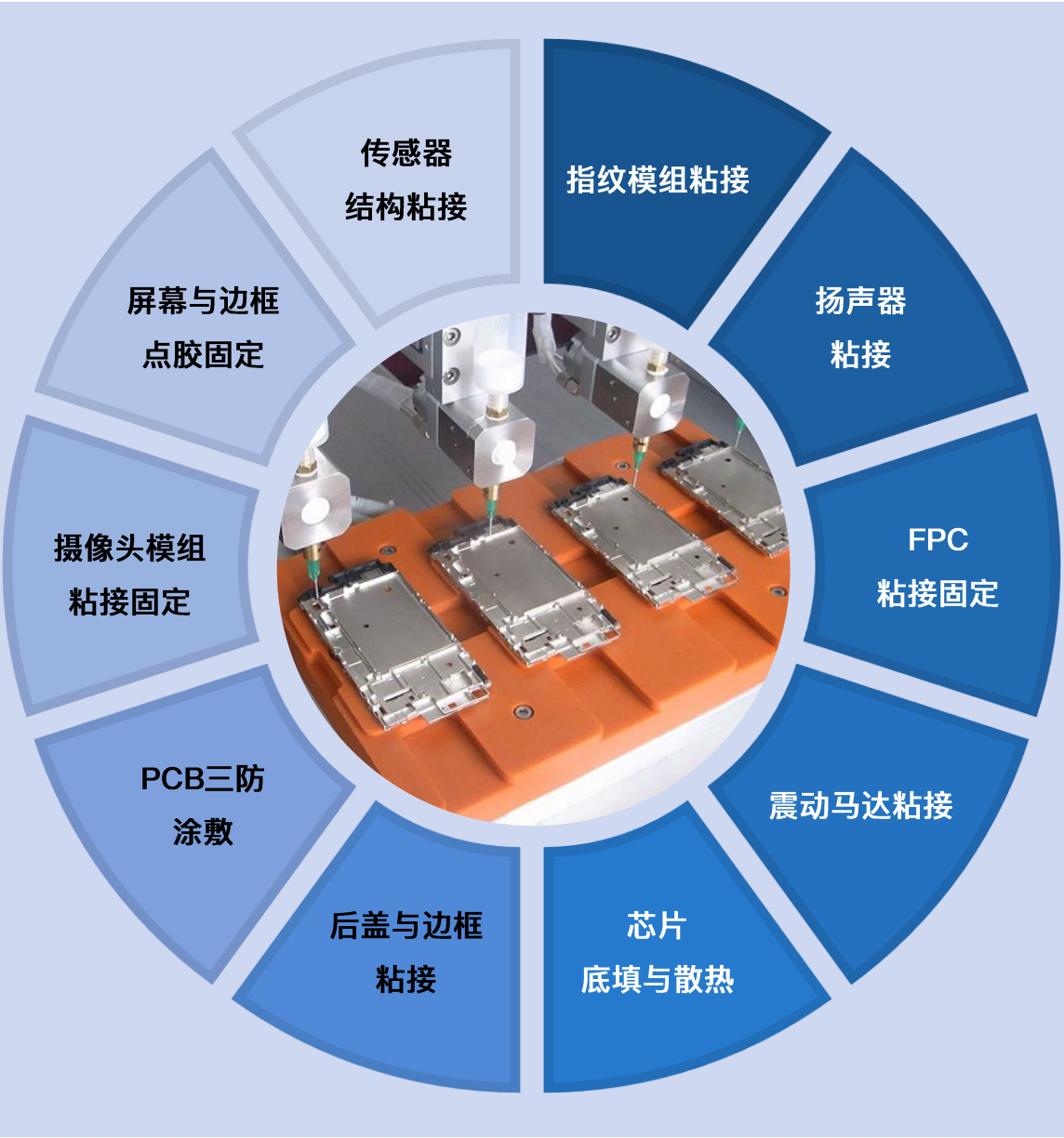


智能手机 胶粘剂应用方案

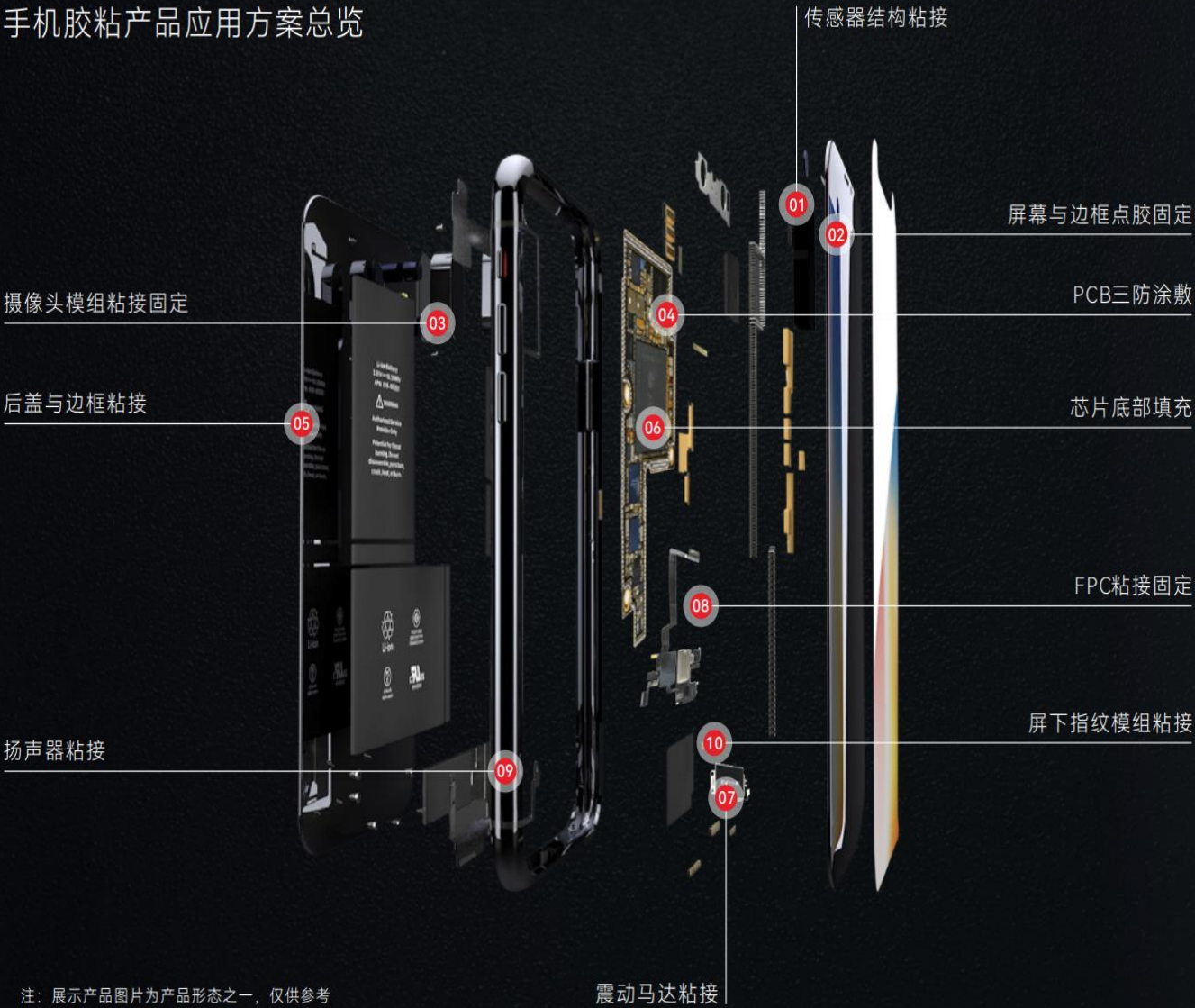
APPLICATION OF ADHESIVE
FOR SMART PHONE

LENS与边框点胶固定 / 摄像头粘接 / 芯片底部填充 / 传感器粘接

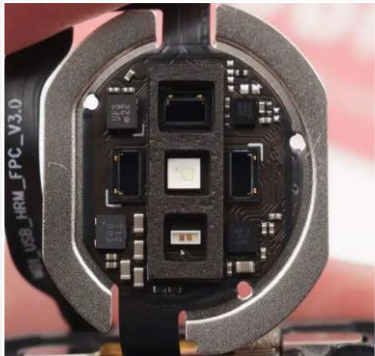




手机胶粘产品应用方案总览



传感器\指纹模组粘接固定

推荐产品	类型	固化	应用特色	应用场景
H3008	聚氨酯PUR	湿气	初粘性高、快速定位，适应多种基材表面粘接	
H2122	环氧	热固	低温固化，适用于温敏传感器件	
H2004	环氧	热固	低模量、低翘曲、高耐湿	
H2024	双组份环氧	室温/加热	耐冲击，耐老化，粘接强度高	

屏幕与边框点胶粘接

推荐产品	类型	固化	应用特色	应用场景
H3007	聚氨酯PUR	湿气	粘接强度高，可靠性优异	
H3008	聚氨酯PUR	湿气	抗冲击，防水能力强	
H3009	聚氨酯PUR	湿气	初粘力强，固化快	
H3583	聚氨酯PUR	湿气	保压时间短，可返修	

后盖与边框点胶粘接密封

推荐产品	类型	固化	应用特色	应用场景
H5001	双组份丙烯酸结构胶	室温	通用型，粘接强度高，可靠性优异	
H5013	双组份丙烯酸结构胶	室温	粘接强度高，黑色，可遮光性	
H6001	有机硅	湿气	固化快，柔韧性好，耐高温	
H6319	改性硅烷	湿气	对多种基材具有较好的粘接性能	

摄像头模组粘接固定

推荐产品	类型	固化	应用特色	应用场景
H2051	改性环氧	UV+热固	摄像头AA制程应用	
H2122LV	环氧	热固	低温固化，适用于温敏传感器件	
H2004	环氧	热固	低模量、低翘曲、高耐湿	
H5224	丙烯酸酯	UV	粘接强度高，抗冲击	

PCB三防涂敷

推荐产品	类型	固化	应用特色	应用场景
H3213	聚氨酯丙烯酸	UV+湿气	无溶剂，硬度高，绝缘性，耐腐蚀， 荧光检视	
H3214	聚氨酯丙烯酸	UV+湿气	UV固化能量低，无溶剂，绝缘性， 耐腐蚀，荧光检视	
H3215	氟素纳米涂层	室温/加热	高疏水性，超薄，耐候性佳	
H6682	有机硅	室温/加热	柔软，低应力，化学稳定性	

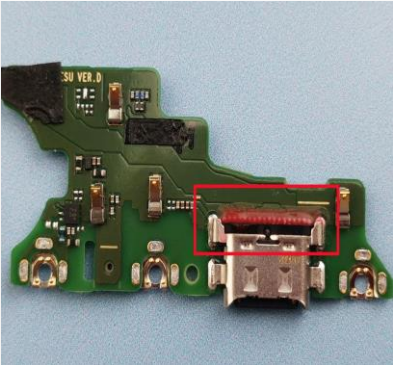
芯片封装\导热\底部填充\主板散热

推荐产品	类型	固化	应用特色	应用场景
H2159	环氧	热固	芯片导电贴装	
TG395	有机硅	热固	芯片导热封装	
H2105	环氧	热固	芯片底部填充	
H6303	导热硅脂	/	主板散热	

扬声器\震动马达\无线充模组粘接固定

推荐产品	类型	固化	应用特色	应用场景
H6312	有机硅	湿气	抗冲击，耐高低温，电气性能佳	
H6322	双组份有机硅	室温	固化快，粘接密封性佳，抗震动	
H5060F	丙烯酸酯	UV+湿气	UV快速粘接定位，湿气二次固化	
H5001	双组份丙烯酸	室温	快速定位，粘接强度高，抗冲击	

PBC焊点保护\FPC补强

推荐产品	类型	固化	应用特色	应用场景
H5107	丙烯酸酯	UV	焊点保护，固化能量低，附着力好，韧性佳	
H5060F	丙烯酸酯	UV+湿气	FPC柔性线路补强、保护	
H5056	丙烯酸酯	UV	焊点保护，附着力好，韧性佳	
H5221	丙烯酸酯	UV	柔软，低应力，FPC补强、保护	

创瑾科技 (TRUMJIN®) 位于湖南长沙, 集研发、生产、销售于一体, 立足电子胶粘剂领域, 致力于更高性能的胶粘材料的研究与开发。公司拥有一支由工程院院士领衔的技术团队, 孵化中科院及国内各大高校科研成果, 为全球客户提供专业的产品和技术支持。创瑾科技秉承“匠心、创新、智慧, 至美”的品牌理念, 矢志推动国产高端电子胶粘剂行业的成长和发展。产品涵盖粘接、密封、三防、灌封、导热、导电六大应用领域, 技术研究涉及环氧、丙烯酸、聚氨酯、硅胶四大方向, 以电子制造行业的核心胶粘需求为出发点, 通过应用市场的横向布局、技术研究和成果转化的纵向探索相结合的模式, 快速响应并及时满足市场需求。



湖南创瑾科技有限公司
Hunan Trumjin Technology Co., Ltd

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路
中国长沙智能终端产业园5号栋
Tel: +86-731-87827556
www.trumjin.com

